

# 合肥颀中科技股份有限公司

## 2025 年度“提质增效重回报”行动方案

为积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，贯彻落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》要求，大力提高上市公司质量，保障和维护投资者合法权益，合肥颀中科技股份有限公司（以下简称“公司”）发布了《合肥颀中科技股份有限公司 2024 年度“提质增效重回报”行动方案》（以下简称“2024 年行动方案”），践行“以投资者为本”的上市公司发展理念。根据行动方案内容，公司积极开展和落实相关工作并以此为基础，持续推动优化经营、规范治理和回报投资者，秉持助力信心提振和资本市场稳定发展的精神，拟开展 2025 年度“提质增效重回报”专项行动。2024 年行动方案主要举措的执行、成效情况及 2025 年行动方案具体内容阐明如下：

### 一、聚焦主业经营，提升经营质量与效率

公司主要从事集成电路的先进封装与测试业务，目前主要聚焦于显示驱动芯片封测领域和以电源管理芯片、射频前端芯片为代表的非显示类芯片封测领域。2024 年，公司实现营业收入 195,937.56 万元，较上年同期增长 20.26%；实现归属于上市公司股东的净利润 31,327.70 万元，较上年同期减少 15.71%；扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润 27,667.68 万元，较上年同期下降 18.55%。

2025 年，公司将继续聚焦主营业务，坚持“以技术创新为核心驱动力”的研发理念，努力提升核心技术水平，持续加大研发投入力度，不断提升产品的市场竞争力和技术领先地位，依托合肥新站区和苏州工业园区的产业集群效应，全面提升公司的核心竞争力、盈利能力，稳固自身行业地位，实现企业的长远、稳健且可持续发展。具体包括以下几个方面：

#### 1、延伸技术产品线，优化产品结构

公司在金凸块制造、晶圆测试、玻璃覆晶封装、柔性屏幕覆晶封装、薄膜覆晶封装等主要工艺环节拥有雄厚技术实力，主要技术指标在行业内属于领先水平。

公司在显示驱动芯片封测领域，持续深耕，保持行业领先地位。显示驱动芯片一直以金凸块为主流，近年金价日益攀升，制造成本随之升高。2024 年公司

积极投入研究铜镍金凸点工艺取代金凸点工艺，在保证性能满足需求的前提下，使显示驱动芯片制造成本降低，实现突破传统材料限制的创新技术，提供多元化的工艺服务。2025 年，公司将更加积极的研究新型凸点结构，为显示芯片封测工艺的提升和变革超前部署，为客户提供多元化的工艺技术解决方案，提高技术和产品的竞争力。

非显示类业务是未来公司优化产品结构、营收增长和战略发展的重点。未来随着大数据、物联网、云计算和人工智能等信息技术高速发展，晶圆将逐步从硅延伸到三五族化合物，且在后摩尔时代，先进封装技术将成为超越摩尔定律的重要决胜点。2025 年，公司将在已有技术的基础上继续深耕，结合目前在凸块制造和覆晶封装等先进封装技术上累积的丰富经验，拓展 DPS 封装技术的相关制程，布局非显示类业务后段制程，健全覆晶封装（FC）工艺，形成凸块制造（Bumping）、晶圆测试（CP）、覆晶封装（FC）、芯片成品测试（FT）的全制程（Turnkey）服务，增加未来竞争力。针对功率器件及集成电路（Power IC）散热及封装趋势，计划建置正面金属化工艺（FSM）&晶圆减薄-背面研磨/背面金属化（BGBM）的制程，可加大对集成电路（Power IC）及功率器件的市场覆盖。如此提升全制程封测能力，进一步降低生产成本，逐步克服在非显示芯片封测业务的后发劣势，向价值链高端拓展，积极扩充公司业务版图。持续与客户进行深度合作，提供整套封装测试的解决方案，增强公司的技术领先优势，并拓宽服务领域至如高性能计算、数据中心、自动驾驶等尖端市场，争取在国际竞争中占据有利地位，为我国集成电路产业链高速发展蓄势赋能。

## **2、力稳品质，降本提效**

过去，公司将风险思维及过程管理模式贯穿于研发、制造、检测的全流程，透过产品质量先期策划及生产件批准流程，严格把控产品质量形成的各阶段，以确保每一件产品都能达到最高标准，满足客户的需求。公司严格按照国际、国内相关法律法规、体系及技术标准要求，倾力建置并实施一套完善的品质管理体系，包含了 IATF16949 汽车行业质量管理体系认证、ISO14001 环境管理体系认证、ISO9001 质量管理体系等一系列国际体系认证。

2025 年，公司将深耕先进的制程技术，通过精准的光刻、研磨等手段，确保生产过程中的工艺精度和稳定性。公司拥有一支具有核心设备改造、配件设计

以及自动化系统开发能力的专业化团队，可将 8 吋 COF 设备的技术改造以用于 12 吋产品，将旧有设备进行提升，提高设备使用效率，大幅节约新设备购置所需的时间和成本。公司从人才优先、精益质量、资源整合、协作并进等方面认真梳理，运用精益管理方法，落实降本增效的重要措施，在充分保证提供之产品和服务的质量下，形成“降低风险、持续改善、提升品质、降本提效”的正向循环。

### **3、积极推进募投项目产能爬坡，实现快速放量**

2024 年度，募投项目颀中先进封装测试生产基地项目、颀中先进封装测试生产基地二期封测研发中心项目、颀中科技（苏州）有限公司高密度微尺寸凸块封装及测试技术改造项目均已完成投入并达到预定的可使用状态，如期结项。2024 年 1 月，公司以显示驱动芯片封测为主的合肥厂正式投产，结合当地上游晶圆厂和下游面板厂的产业链完整度等情况，进一步提升公司的盈利能力。2025 年度，公司将持续充分调配内部各项资源，为后续项目开展储备人才。

### **4、外延发展，布局产业链**

2025 年，在自身不断夯实主营业务的同时，公司将积极探索通过并购整合适合的标的，从技术互补、规模扩张或市场拓展等方面来提升公司的综合竞争力，在充分考量业务布局、协同效应、创新性及独特性的前提下，重点关注集成电路产业链上增长潜力大，技术门槛高的企业。公司将对并购标的进行充分、详尽的尽职调查，评估目标公司的风险和潜在收益，确保并购行为符合公司的发展战略，同时，公司将严格遵守信息披露相关规定，确认实施过程中真实、准确、完整、及时、公平的披露信息，保障广大投资者知情权益。

## **二、以技术创新驱动发展，持续研发投入，强化竞争力**

### **1、持续加大研发投入，扎实推进知识产权孵化**

公司采用自主研发模式，以市场和客户为导向，坚持突破创新，不断发展先进封测技术，并设立专业的研发组织及制定完善的研发管理制度。公司技术研发中心负责统筹规划先进封测及相关技术的发展与落实，并拥有一支经验丰富、技术领先的研发团队作为保持技术优势的中坚力量，在新型凸块制造工艺以及封装测试工艺开发的同时，也可快速将研发成果转化为实际生产应用，使得相关技术可在较短时间内形成竞争力。

2024 年度，公司研发投入 15,468.66 万元，较上年同期增长 45.53%，且截至 2024 年末，公司研发人员数量增至 284 人，较上年同期增长 26.22%，研发人员数量占公司比例为 12.96%。同时，2024 年公司获得授权发明专利 11 项（中国 7 项，国际 4 项）、授权实用新型专利 10 项，软件著作权 1 项，包括晶圆表面介电层的制备方法、晶圆结构及凸块的成型方法、一种电镀导电治具、一种用于芯片散热贴的取标头、散热粘贴装置及粘贴方法、覆晶封装结构的形成方法、覆晶封装结构及显示装置、用于去除卷带芯片的芯片剔除装置、适于高粘度光阻的缓冲装置与光阻供液系统、可挠性线路板、薄膜覆晶封装结构及显示装置、散热贴贴附方法、封装方法、封装构型及贴附装置、用于芯片封装的顶针装置、芯片重布线结构及其制备方法等在内的授权专利均为自主研发，且上述技术大部分已在公司产品上实现了应用。

2025 年度，公司将聚焦于倒装芯片封装、多层堆叠封装及新材料应用等先进封装技术领域上，顺应行业发展趋势及新技术的迭代升级，从 AMOLED、Micro Oled 到新能源车、5G、Wifi7 连接等新型应用选定关键立基点，锚定目标聚力前行，推进新研发项目的开展，促进原创性、颠覆性的科研成果，为发展新质生产力持续赋能，夯实公司高质量发展的“硬实力”。

## **2、重视人才队伍建设，提升激励水平，吸引并培育高素质人才**

2024 年 5 月 24 日，公司发布了《关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告》，对公司 253 名员工开展股权激励，利用工具构建核心员工与企业风险共担、利益共享的长效激励机制，提升了公司经营团队及核心员工的忠诚度与稳定度，促进了员工创新与发展，吸引并留任优秀人才，激励员工的积极性，同时提升了公司长期经营实力与竞争力，为公司长远发展注入持久动力。未来，公司将严格按照股权激励计划要求实施考核，并继续贯彻长效激励的理念，开展连续性的股权激励计划，有效地将核心团队个人利益与公司长远利益结合在一起，激发员工与企业共进退的内生动力。

2025 年，公司将继续坚持“人才优先”的经营方针，构建全面系统的人才发展体系。对内，通过定期培训、学术研讨、对外交流、导师带徒等途径，提升员工的业务能力与整体素质。对外，积极延揽行业内专业优秀人才，提供市场化的薪酬条件及畅通的晋升管道。此外，公司还将优化人才激励机制，充分调动员工

的工作积极性，在鼓励员工个性化、差异化发展的同时，培养团队意识，增强合作精神。同时公司持续深化校企科研合作，持续引进优秀的研发人才，不断优化人才体系建设，增强公司的竞争实力。

### **三、树立股东回报意识，重视投资者回报，共享公司发展成果**

公司坚持稳健、可持续的分红策略，遵照相关法律法规等要求严格执行股东分红回报规划及利润分配政策，结合实际及未来规划，制定合理的利润分配方案。公司已在《合肥颀中科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）中规定了利润分配的相关条款，明确了公司利润分配尤其是现金分红的具体条件、比例和分配形式等，完善了公司利润分配的决策程序、机制以及利润分配政策的调整原则，强化了中小投资者权益保障机制。公司已于 2024 年 11 月 22 日完成 2024 年前三季度利润分配，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.5 元（含税），共分配现金红利人民币 59,451,864.40 元，加上 2024 年度预计向全体股东每 10 股派发现金红利 0.5 元（含税），不送红股，不以公积金转增股本，拟派发现金红利 59,451,864.40 元。公司 2024 年度合计派发现金红利人民币 118,903,728.80 元，占 2024 年度归属于上市公司股东的净利润比例为 37.95%。

2025 年，公司将更加注重投资者回报，根据自身所处发展阶段，着眼于长远和可持续发展，在综合分析公司经营发展实际情况、融资环境以及股东意愿等因素的基础上，兼顾公司长远利益、全体股东的整体利益及公司的可持续发展能力，统筹公司发展、业绩增长与股东回报的动态平衡，积极探索更加有效的方式方法，在符合相关法律法规及《公司章程》的前提下，坚持为投资者提供持续、稳定的现金分红方案，致力于为股东带来长期、稳定、可持续的价值回报。

### **四、完善公司治理、保持规范运作、推动高质量发展**

公司高度重视公司治理结构的健全和内部控制体系的有效性，形成了由股东大会、董事会、监事会、独立董事和管理层组成的健全的公司治理结构。2025 年，公司将不断完善治理结构、健全内部控制体系建设、进一步推动治理体系构建和治理水平提升，通过打造更高效的管理体系、更科学的管理机制来合规运营，保障投资者的合法权益，实现公司发展的良性循环。具体内容如下：

#### **1、规范三会运作，持续完善公司治理结构**

2024 年度，公司严格遵守相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，不断优化、完善法人治理结构，及时对治理规则中的有关条款进行修订及完善，建立了符合上市公司治理规范性要求的《合肥颀中科技股份有限公司股东大会议事规则》《合肥颀中科技股份有限公司董事会议事规则》《合肥颀中科技股份有限公司董事会秘书工作细则》《合肥颀中科技股份有限公司董事会审计委员会实施细则》《合肥颀中科技股份有限公司董事会提名、薪酬与考核委员会实施细则》等制度，并设置战略委员会、审计委员会、提名、薪酬与考核委员会等董事会下属专门委员会。公司充分尊重和发挥监事会、独立董事和董事会专门委员会的作用，坚持合规、有效管理。

2025 年，公司将进一步保障独立董事履职条件，充分发挥独立董事在参与决策、专业咨询、制衡监督等方面的作用，不断提升公司董事会决策的科学性和合理性，有效提升公司规范化运作水平。持续安排董监高参加专业机构和公司内部专业人员的培训，推动公司董监高在尽职履责的同时，学习证券市场相关法律法规、理解监管动态，培养自身自律和合规意识，提高其履职能力和水平。

## **2、加强合规管理，深化内部审计工作**

公司始终严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规的要求，完善公司法人治理结构，健全内部控制制度，确保法人治理结构的有效运行，根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、上海证券交易所最新发布的相关规则，2024 年度，公司结合实际运行情况，完成了《合肥颀中科技股份有限公司独立董事工作制度》《合肥颀中科技股份有限公司对外担保管理办法》《合肥颀中科技股份有限公司关联交易管理办法》《合肥颀中科技股份有限公司信息披露管理办法》《合肥颀中科技股份有限公司投资者关系管理办法》《合肥颀中科技股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法》《合肥颀中科技股份有限公司市值管理制度》《合肥颀中科技股份有限公司舆情管理制度》等多项制度的修订或制定工作，为公司经营管理的合规有效提供了保障，为公司高质量发展保驾护航。

2025 年，公司将在现有的治理水平上不断完善，采取适当措施确保公司合规运作，包含加强对子公司在业务发展、资源整合、要素共享等方面的统筹，发

挥战略协同优势；加强质量管理，进一步完善质量管理体系，并加强安全管理，持续推进安全标准化体系的建设，严格执行各种安全生产规章制度；持续优化现有业务流程，并梳理新业务管理流程，借助信息化工具实现高效管理目标，全面有效地控制公司经营和管理风险。同时，公司将持续深化落实内部审计工作，董事会办公室、财务部、会计部、内审部等相关部门协同推动风险防控措施的执行，重点开展内部专项审计，确保审计结果的持续跟踪与有效反馈，以高质量内部审计助力公司合规运行，提高公司运营的规范性和决策的科学性，全面保障股东权益。

## 五、提高信息披露水平，加强投资者沟通

公司严格遵循法律法规以及中国证监会与上海证券交易所的相关规定，认真履行信息披露义务，确保信息披露的真实、准确、完整、及时、公平，增强公司透明度，确保所有投资者有平等机会获取公司信息，建立了较为完整且规范的投资者关系工作体系，设立了投资者关系专用邮箱与投资者沟通热线，并于公司官网设置“投资者关系”频道，其中下设了“公司治理”、“财务摘要”、“信息公告”、“投资者联系”多个分栏，使得投资者关系工作更高效，更容易上传下达，切实维护好投资者获取信息的平等性，在符合监管规定的基础上，不断探索创新，以更好的达成投资者关系工作的效果。2024年，公司召开了3次公开业绩说明会并定期查看上证E互动投资者提问，详细解答投资者疑问，积极传递公司价值。

2025年，公司继续严谨、合规、高质量开展信息披露工作，进一步强化与投资者的沟通交流，增进投资者对公司全方位的了解，为其提供准确的投资决策依据，不断完善投资者意见传递渠道，了解投资者的真实诉求，并通过各种渠道有针对性地及时回应，保障投资者的知情权，不断提升公司信披质量，树立市场信心。具体措施如下：

1、在定期报告披露后，公司将积极邀请投资机构、分析师及有意向的中小投资者，参与公司业绩交流会或者线上线下投资者调研活动，详细解答投资者疑问。2025年，公司计划开展不少于3次（含）的公开业绩说明会，不定期接受线上/现场调研，广泛邀请投资者特别是中小投资者、分析师等参加，通过电话、视频、图示、文字等多种方式积极与投资者交流互动，全方位传递公司价值，降低投资者门槛，保障各类投资者的各项权益。

2、公司将提高上证 e 互动平台及投资者关系邮箱的回复率，设置投资者专线电话实时转接服务，积极接听投资者热线，确保投资者问询渠道畅通无阻。

3、加强对内幕信息等重点事项的管理，要求内幕信息知情人积极参与监管部门组织的信息披露专项培训，签订相关保密协议，防范重大信息泄露风险。

## 六、强化“关键少数”责任

过去，公司通过多维度方式重点加强关键少数——控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员的相应职责，以切实的行动提升治理水平。在上市过程中，“关键少数”人员按照法律法规的相关要求就股份限售及稳定股价等方面进行了承诺。上市后，组织“关键少数”人员参加市场监管部门组织的法定培训，充分借助上海证券交易所浦江大讲堂、上市公司协会培训平台等监管培训资源，组织“关键少数”及公司经营管理层进行线上、线下的培训，确保“关键少数”了解最新的法律法规，提升其履职技能和合规知识储备，推动公司整体治理水平的全面提升。此外，公司于 2024 年限制性股票激励计划中设置了净利润率、每股收益的考核指标，在注重经营业绩增长外，也要求公司保持良好的股东回报能力与优秀的经营效率，重视投资者利益，落实“提质增效重回报”。

2025 年，公司将持续关注监管政策变化，及时向“关键少数”传达最新监管精神，强化其合规意识，确保履职规范。同时，进一步完善公司薪酬绩效考核评价体系，将公司的市值表现、经营业绩等指标与管理层的薪酬绩效挂钩，激发管理层的创造力与活力，保证公司的健康可持续发展。

## 七、其他

公司将持续评估 2025 年度“提质增效重回报”行动方案具体举措执行情况，通过专注主营业务，推进技术创新和升级；拓展销售渠道，提升业绩表现和盈利能力；及时披露信息，保证同投资者良性互动；规范公司治理，完善运行结构；树立股东回报意识，增强投资者回报等方式切实履行好上市公司的责任和义务，回馈投资者的信任，维护公司市场形象，共同促进科创板市场平稳运行。

特别提示：本行动方案是基于目前公司的实际情况而作出的判断，所涉及的公司发展战略、发展规划等内容系非既成事实的前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，未来可能会受到国内外市场环境因素、政策调整等因素影响，具

有一定的不确定性，敬请投资者注意相关风险。

合肥颀中科技股份有限公司

董事会

2025年4月1日